公司代码：688183 公司简称：生益电子

生益电子股份有限公司2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

本公司已在本报告中详细地描述了存在风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来可能面对的风险因素。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司2025年度利润分配方案拟定如下：本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基础，向登记在册全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税)。截至本报告披露日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份后的股本为82,302.7059万股，以此计算合计拟派发现金红利49,381.6235万元(含税)。2025年半年度公司已派发现金红利24,707.6072万元(含税)。

综上所述，本年度公司现金分红预计合计为74,089.2307万元，占本年度归属于母公司所有者的净利润比例为50.29%，占当期末母公司报表中未分配利润比例为44.11%。本年度利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，母公司所余未分配利润全部结转至下一次分配。本次利润分配不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司2025年度利润分配方案已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后实施。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	生益电子	688183	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐慧芬	杭海梅
联系地址	广东省东莞市东城区(同沙)科技工业园园振路33号	广东省东莞市东城区(同沙)科技工业园园振路33号
电话	0769-89281988	0769-89281988
传真	0769-89281998	0769-89281998
电子信箱	bo@sye.com.cn	bo@sye.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司自1985年成立以来始终专注于各类印制电路板的研发、生产与销售业务。公司印制电路板产品定位于中高端应用市场，具有高精度、高密度和高可靠性等特点，产品按照应用领域划分主要包括计算机/服务器板、通信网络设备板、汽车电子板、消费电子板、工控医疗板及其他板等。

2.2 主要经营模式

公司的客户主要聚焦在计算机/服务器、通信网络设备、汽车电子、消费电子、工业控制、医疗、航空航天等行业。作为电子产品生产制造的关键环节，公司通过不断提升技术水平和扩大产能，使产品质量和技术能力不断满足下游客户电子产品的需求与变化。因产品为客户定制，公司生产模式为“按单生产”方式，即公司根据客户合同需求，组织产品研发、生产、检验并交货；销售模式方面，由于PCB规格型号众多，不同产品的性能差异较大，产品的选择和加工需要具备较强的专业知识，因此公司在销售产品的同时还对下游客户提供全面的技术服务，这一业务特点决定了公司的销售模式是以直接面向客户的直销方式为主。公司具体的经营模式如下：

1)盈利模式

公司主要通过核心技术和不断提升的产能为客户提供定制化PCB产品来获取合理利润，即采购覆铜板、半固化片、金盐、铜球、铜箔、干膜和油墨等原材料和相关辅料，使用最优的生产流程及工艺设计，利用公司的核心技术、产能生产出符合客户要求的PCB产品，销售给境内外客户。

2)采购模式

公司采购的原材料主要包括覆铜板、半固化片、金盐、铜球、铜箔、干膜和油墨等。公司主要采取“按单采购”和“同类合并采购”的模式，即按照客户订单要求采购原材料。定期复核采购情况，采购价格和数量随市场价格和订单而定。

公司采购原材料时通过SRM(供应商关系管理)系统在线广泛寻源，向供应商询价并对样品进行检验和封样，在对技术、品质、价格、供货速度及持续供货能力等进行严格的评价考量后，选择优质供应商资源，安排采购订单，并通过SRM系统实现采购业务全过程的闭环管理，建立了科学、有竞争力的采购供应体系。

3)生产模式

由于印制电路板为定制化产品，公司主要采取“按单生产”的生产模式。生产计划部根据用户订单的产品规格、客户需求交期、质量要求和数量组织生产，质量管理部负责对生产流程中的产品和最终产品进行检验。公司能够紧密跟踪客户的需求，根据下游客户的应用需求，进行PCB产品研发，为客户提供性能优异的PCB产品并根据客户的产品升级需要做好长期技术储备，并为客 户提供最优的可制造方案，与客户建立长期稳定的合作关系。

4)销售模式

公司主要采取直销及少量经销的销售方式。直销是指向终端客户进行销售；经销是指通过PCB贸易商向终端客户进行销售。经过多年发展，公司建立了较为完善的全球销售网络和售后服务体系。公司的市场营销人员和技术支持人员协同公司各职能部门按照客户需求进行分工，共同负责公司对境内外客户的售前、售中和售后服务，公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系。

5)研发模式

在自主研发方面，公司设立了较为完善的研发机构即研发中心，建立了完善的研发体系，进行新产品、新技术、新工艺和新材料的研发试制，不断优化产品性能。公司研发中心设有新产品开发组、基础性研究/前瞻性预研究组、知识产权管理组等。新产品开发组主要负责对新产品进行开发；基础性研究/前瞻性预研究组负责在未涉及新产品、新工艺、新技术的应用的情况下，而开展与PCB设计、制程相关的基础知识研究；知识产权组负责研发相关的项目申报、知识产权等工作。

公司研发中心根据公司发展战略及市场发展方向进行研发选题、立项，通过新项目的研发及时响应客户需求，参与客户下一代产品的开发与设计，与客户形成长久且稳固的合作关系。

2.3 所处行业情况

(1)、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

印制电路板(Printed Circuit Board，简称“PCB”)，又称为印制线路板、印刷电路板、印刷线路板。通常把在绝缘基材上，按预定设计制成印制线路、印制元件或两者组合而成的导电图形称为印制电路，而在绝缘基材上提供元器件之间电气连接的导电图形，称为印制线路。

PCB诞生于20世纪30年代，采用电子印刷术制作，以绝缘板为基材，有选择性的加工孔和布设金属的电路图形，用来代替以往装置电子元器件的底盘，并实现电子元器件之间的相互连接，起中续传输的作用，是电子元器件的支撑体，有“电子产品之母”之称。该产业的发展水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子产业的整体发展速度与技术水准。随着电子行业的发展，PCB的应用将越来越广泛。

PCB产品分类方式多样，行业中常用的分类方法主要有按照线路图层数、产品结构和产品用途等几个方面进行划分，具体情况如下：

① 按线路图层数进行分类

产品种类	简介
单面板	最基本的印制电路板，零件集中在其中一面，导线则集中在另一面上。因为导线只出现在其中一面，所以称为单面板，主要应用于较为早期的电路。
双面板	在绝缘基板两面均有导电图形，由于两面都有导电图形，一般采用金属化孔使两面的导电图形连接起来，此类PCB可以通过金属孔使布线绕到另一面而相互交错，因此可以用到较复杂的电路上。
多层板	有四层或四层以上导电图形的印制电路板，内层是由导电图形与绝缘粘结片叠合压制而成，外层为铜箔，经压制成为一个整体。为了将关在绝缘基板中间的印刷导线引出，多层板上安装元件的孔(即导孔)需经金属化孔处理，使之与夹在绝缘基板中的印刷导线连接。多层板导电图形的制作以感光法为主。层数通常为偶数，并且包含最外侧的两层。

② 按产品结构进行分类

产品种类	产品特性	应用领域
刚性板(硬板)	由不易弯曲、具有一定强韧度的刚性基材制成，具有抗弯能力，可以为附着其上的电子元件提供一定的支撑。刚性基材包括玻纤布基板、纸基板、复合基板、陶瓷基板、金属基板、热塑性基板等。	广泛分布于计算机及网络设备、通信设备、工业控制、消费电子和汽车电子等行业。
挠性板(软板)	指用柔性的绝缘基材制成的印制电路板。它可以自由弯曲、卷绕、折叠，可依照空间布局要求任意安排，并在三维空间任意移动和伸缩，从而达到元器件装配和导线连接一体化。	智能手机、笔记本电脑、平板电脑及其他便携式电子设备等领域。
刚挠结合板	指在一块印刷电路板上包含一个或多个刚性区和挠性区，将薄层状的挠性印刷电路板底层和刚性印刷电路板底层结合层压而成。其优点是既可以提供刚性板的支撑作用，又具有挠性板的弯曲特性，能够满足三维组装需求。	先进医疗电子设备、便携摄像机和折叠式计算机设备等。
HDI板	High Density Interconnect的缩写，即高密度互连技术，是印制电路板技术的一种。 HDI板一般采用积层法制造，采用激光打孔技术对积层进行打孔导通，使整块印刷电路板形成了以埋、盲孔为主要导通方式的层间连接。 相较于传统多层印制板，HDI板可提高板件布线密度，有利于先进封装技术的使用；可使信号输出品质提升；还可以使电子产品在外观上变得更为小巧方便。	主要是高密度需求的消费电子领域，广泛应用于手机、笔记本电脑、汽车电子和其他数码产品等，其中以手机的应用最为广泛。 目前通信产品、网络产品、服务器产品、汽车产品甚至航空航天产品都有用到HDI技术。
封装基板	即IC封装载板，直接用于搭载芯片，可为芯片提供电连接，保护、支撑、散热、组装等功效，以实现多引脚化，缩小封装产品体积、改善电性能及散热性、超高密度或多芯片模块化的目的。	在智能手机、平板电脑等移动通信产品领域，封装基板得到了广泛的应用。如存储用的存储芯片、传感用的微机电系统、射频识别用的射频模块、处理器芯片等器件均要使用封装基板。而高速通信封装基板已广泛应用于数据宽带等领域。

③ 按产品用途进行分类

产品种类	简介
通信设备板	主要应用于移动通信基站及周边信号传输产品等通信设备上的各类印制电路板。
网络设备板	主要应用于骨干网传输、路由器、高端交换机、以太网交换机、接入网等网络传输产品。
计算机/服务器板	主要应用于各式服务器及网络计算机等领域。
汽车电子板	主要应用于汽车安全、中控及高端娱乐系统、电动能源管理系统、自动驾驶传感及毫米波雷达等产品。
消费电子板	主要应用于智能手机及其配套设备等与现代消费者生活、娱乐息息相关的电子产品。
工控设备板	主要应用于嵌入式主板、工业电脑等。
医疗器械板	主要应用在CT、核磁共振仪、超声、呼吸机等。
航空航天板	主要应用于航电系统和机电系统，其中航电系统主要包括飞行控制、飞行管理、座舱显示、导航、数据与语音通信、监视与告警等功能系统；机电系统主要包括电力系统、空气管理系统、燃油系统、液压系统等功能系统。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

① 公司所处行业地位

印制电路板的应用领域非常广泛，涵盖了通信设备、网络设备、计算机/服务器、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗、航空航天等。生益电子成立于1985年，长期专注并深耕于印制电路板行业，产品以计算机/服务器、通讯网络、汽车电子等应用领域的印制线路板为主，兼顾了消费电子、工控医疗、航空航天等领域知名企业的重要产品，属于中国印制线路板行业领先企业之一。根据Prismark发布的2025年第四季度市场报告，公司在全球PCB40强中排名第20位。

② 印制电路板行业产值规模及分布

2025年全球经济在动荡中展现韧性，预计增长3.2%。全球经济在多重挑战与结构性机遇中并行发展，贸易保护主义与地缘冲突扰动多边贸易体系及全球供应链；而人工智能投资浪潮与绿色转型深化，全球南方国家崛起，注入世界经济增长的新动能。根据Prismark数据，2025年全球PCB市场产值同比增长15.8%，达851.52亿美元。从中长期来看，伴随人工智能的投资和发展，进而带动了PCB产业的发展，全球PCB行业在2025年至2030年复合增长率为7.7%，总体保持平稳增长。

根据Prismark预测，未来几年，中国仍将是PCB行业的主要制造中心。2025年国内PCB市场产值达489.69亿美元，同比增长19.2%。预测2025年至2030年总体保持增长，复合增长率为7.0%，反映了中国在PCB行业的核心地位，资金雄厚的公司探索新的市场机会。Prismark预计未来五年各个国家和地区的PCB产值增长情况如下：

单位:亿美元

国家和地区	2025E	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2025-2030复合增长率
中国大陆	489.69	552.69	599.82	629.84	659.63	685.35	7.0%
日本	64.99	72.57	77.78	82.56	88.48	94.68	7.8%
美洲	37.96	40.29	42.25	43.55	45.58	47.81	4.7%
欧洲	18.64	19.93	20.75	21.39	22.07	23.07	4.4%
亚洲(除中国大陆、日本)	240.24	272.33	290.26	312.93	344.52	382.57	9.8%
合计	851.52	957.80	926.42	1090.27	1160.28	1233.48	7.7%

数据来源：Prismark

③ 印制电路板行业产品结构及需求变化

根据Prismark统计，受人工智能服务器需求强劲以及其他大多数电子市场复苏的推动，2025年每个PCB产品结构均出现不同程度的增长，其中18层以上多层板和HDI增长最为强劲，分别为72.8%和26.0%。中长期来看，18层以上多层板、HDI和封装基板将保持相对较高的增长，2025年至2030年复合增长率分别达到21.7%、9.2%和10.9%，高于总体增长。Prismark的统计及预测情况如下：

单位:亿美元

产品结构	2024	2025E	2025增长率	2030E	2025-2030年复合增长率
单/双面板	79.47	84.4	6.2%	97.09	2.8%
4-6层	155.86	165.56	6.2%	194.93	3.3%
8-16层	95.55	116.65	22.1%	159.85	6.5%
18层以上	28.53	49.28	72.8%	131.59	21.7%
HDI	125.18	157.69	26.0%	244.9	9.2%
封装基板	126.02	148.91	18.2%	249.86	10.9%
软板	125.04	129.03	3.2%	155.27	3.8%
合计	735.65	851.52	15.8%	1233.48	7.7%

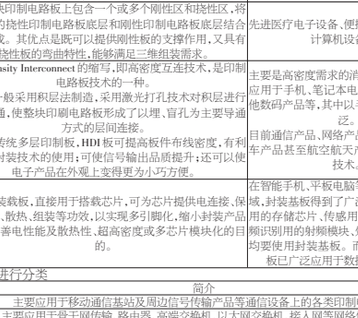
数据来源：Prismark

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

生益电子以印制线路板为主业，以传统优势的通讯网络行业、长期深耕的服务器行业、快速发展的汽车电子行业为公司下游主攻方向，同时在已有的高难度复合多种特殊工艺多层板产线外新建成了高精度HDI产线及软硬结合板产线。力求实现行业产品的全品类布局，提升行业市场占有率，进一步增强公司核心竞争力。

通讯行业

为支持人工智能/机器学习训练等高性能计算算力负载，AI后端网络的迭代周期缩短至两年甚至更短，远比传统前端网络的升级周期更加快速和激进。Dell'Oro预测2025年部署在AI后端网络中的交换机端口以800G为主，到2027年将过渡至1.6T，到2030年将达到3.2T。云服务市场数据中心交换机端口展现出更快的速率迭代，2029年1.6T及以上端口交换机的市场规模占比将达到70%以上。



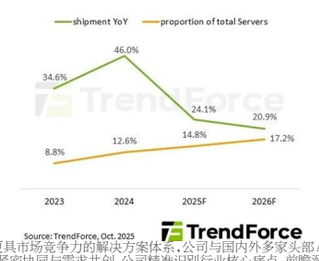
来源：Dell'Oro Group，650 Group

报告期内，公司凭借敏锐的市场洞察力，科学调整发展策略，有力推动了通讯网络板块的稳健发展。公司始终坚守战略定位，聚焦高端产品的研发与创新，积极寻求与行业头部企业的合作机遇。目前，公司在1.6T高端交换机领域已实现技术突破，相关产品成功进入样品阶段，为抢占未来高速通信市场奠定了坚实基础。与此同时，公司在卫星通信这一前沿领域也取得了积极进展，通过持续的技术攻关，公司已完成卫星通信相关系列产品的研发，并成功实现了小批量量产。展望2026年，公司在该领域的产量有望逐步提升，这将为开拓空天地一体化通信市场，打造新的增长点构建坚实基础。

服务器行业

根据TrendForce的最新AI服务器产业分析，2026年，因来自云端服务业者(CSP)，以及主权云的需求持续稳健，对GPU、ASIC拉货动能将有所提升，加上AI推理应用蓬勃发展，预计全球AI Server出货量将年增20%以上，占整体Server比重上升至17%。

2023-2026年AI Server出货年成长及占整体Server比例

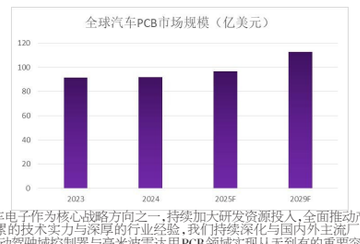


报告期内，为构建更具市场竞争力的解决方案体系，公司与国内外多家头部AI服务器企业建立了深度合作关系。通过紧密协同与需求共创，公司精准识别行业核心痛点，前瞻洞察技术演进趋势，并依托在高端PCB制造领域积累的深厚工艺经验，对AI服务器相关产品进行了系统性、多维度的技术优化与性能升级。

报告期内，公司服务器产品销售收入占比达60%以上，其中AI服务器产品领域尤其取得显著突破，成为驱动公司整体业绩快速增长的核心引擎。展望2026年，随着AI市场需求持续爆发，公司将继续聚焦技术领先战略，进一步加大研发投入，强化技术储备，并同步推进产能布局优化与规模扩张，以全面响应客户对高端PCB产品日益提升的需求，巩固并增强公司在细分领域的竞争优势。

汽车电子行业

EVTank数据显示，2025年全球新能源汽车销量达到2,354.2万辆，同比增长29.1%；中国新能源汽车销量达到1,655万辆，同比增长28.6%。预计2026年全球新能源汽车销量将达到2,849.6万辆，其中中国将达到1,979.6万辆，2030年全球新能源汽车销量有望达到4,265万辆，总体渗透率将超过40%。汽车在电动化、网联化、智能化三大趋势下，汽车电子产品在整车占比中不断提高，汽车电子在传统高级轿车中的价值量占比约28%，在新能源车中则能达到47%-65%。新能源汽车销量持续增长拉动汽车PCB的需求，根据Prismark数据，2025年汽车PCB市场增长5.3%，2024-2029F年平均复合增长率为4.2%。



公司坚定将汽车电子作为核心战略方向之一，持续加大研发资源投入，全面推动产品工艺与技术升级。依托长期积累的技术实力与深厚的行业经验，我们持续深化与国内外主流厂商的合作开发。报告期内，公司在自动驾驶域控制器与毫米波雷达用PCB领域实现从无到有的重要突破，相关核心产品已获批量订单。

随着汽车智能化进程加速，市场对PCB的技术要求日益提高，高端工艺已成为竞争关键。为此，公司将持续扩大汽车专线的布局与投入，打造技术领先优势，致力于在快速演进的市场中保持领先地位。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	11,238,386,935.93	7,685,549,652.77	46.23	6,284,056,602.79
归属于上市公司股东的净资产	5,745,514,933.20	4,273,186,784.36	34.46	3,926,700,668.03
营业收入	9,493,763,839.18	4,686,630,826.09	102.57	3,273,012,827.91
利润总额	1,658,012,228.28	350,877,301.94	372.53	-56,875,997.65
归属于上市公司股东的净利润	1,473,148,860.35	331,973,153.83	343.76	-24,993,631.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,467,541,389.46	327,049,615.14	348.72	-43,664,946.38
经营活动产生的现金流量净额	1,621,124,475.95	350,728,705.70	362.22	431,380,829.09
加权平均净资产收益率(%)	29.74	8.24	增加21.50个百分点	-0.63
基本每股收益(元/股)	1.80	0.40	350.00	-0.03
稀释每股收益(元/股)	1.73	0.40	332.50	-0.03
研发投入占营业收入的比例(%)	5.14	6.05	减少0.91个百分点	5.89

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,579,448,108.26	2,189,269,968.08	3,060,224,687.25	2,664,821,075.59
归属于上市公司股东的净利润	200,182,838.04	330,331,066.83	584,163,923.25	358,471,032.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	197,966,647.75	330,164,260.16	583,745,431.91	355,665,049.64
经营活动产生的现金流量净额	182,796,891.97	249,773,457.10	374,992,382.53	813,561,744.35

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	40,484
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	40,028
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广东生益科技股份有限公司	0	523,482,175	62.93	0	无	0	境内非国有法人
东莞市国弘投资有限公司	0	66,442,666	7.99	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	9,734,636	9,734,636	1.17	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	9,099,914	9,099,914	1.09	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-3,176,628	7,520,735	0.90	0	无	0	未知
新余腾盈投资管理中心(有限合伙)	-2,292,931	6,884,169	0.83	0	无	0	境内非国有法人
新余超盈投资管理中心(有限合伙)	-2,071,500	6,220,500	0.75	0	无	0	境内非国有法人
新余联盈投资管理中心(有限合伙)	-2,025,314	6,082,286	0.73	0	无	0	境内非国有法人
新余益信投资管理中心(有限合伙)	-1,896,968	5,696,732	0.68	0	无	0	境内非国有法人
交通银行股份有限公司-德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金	3,708,195	4,197,098	0.50	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.东莞市国弘投资有限公司与东莞科技创新投资集团有限公司属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2.东莞市国弘投资有限公司直接持有广东生益科技股份有限公司的股份，持股比例不足30%。东莞市国弘投资有限公司、广东生益科技股份有限公司均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形。 3.除此之外，公司前十名股东中，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

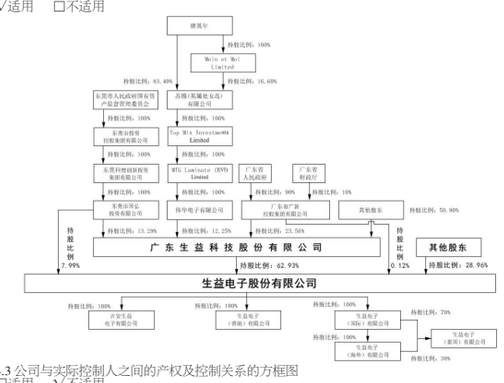
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入为949,376.38万元，与上年同期相比增加102.57%。归属于上市公司股东的净利润147,314.89万元，与上年同期相比增加343.76%。公司坚持“市场引领，双轮驱动”的经营理念，聚焦高端领域市场拓展，加大研发投入，推进提产扩产进程，同时强化质量管理，以质量筑牢根基，报告期内高附加值产品占比提升，使公司在中高端市场的竞争优势得到进一步巩固，实现净利润较上年同期大幅增长。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2026-029

生益电子股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月7日(星期四)下午13:45-14:45

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年4月30日(星期四)至5月6日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 report@mthreads.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

生益电子股份有限公司(以下简称“公司”)将于2026年4月24日发布公司2025年年度报告，及2026年4月29日发布2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月7日(星期四)下午13:45-14:45举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2026年5月7日(星期四)下午13:45-14:45

(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事长：邓春华先生

总经理：张恭敏先生

副总经理：陈正清先生

董事会秘书兼财务总监：唐慧芬女士

独立董事：陈文吉女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月7日(星期四)下午13:45-14:45，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年4月30日(星期四)至5月6日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 bo@sye.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法联系人

联系人：杭女士

电话：0769-89281988

邮箱：bo@sye.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

生益电子股份有限公司

2026年4月24日

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2026-023

生益电子股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]7号)同意，生益电子股份有限公司(以下简称“生益电子”“公司”)首次公开发行人民币普通股股票16,636.40万股，每股发行价格为人民币12.42元，募集资金总额为人民币206,624.0880万元，发行费用总额9,130.1959万元(不含税)，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币197,493.8921万元。该募集资金已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2021年2月19日出具了《验资报告》(华兴验字[2021]21000250047号)。

公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2025年12月31日，本次募集资金的使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年2月19日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	206,624.09
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	9,130.20
二、募集资金净额	197,493.89
减：	
以前年度已使用金额	136,243.43
本年度使用金额	36,551.04
暂时补流金额	
现金管理金额	
加：	
募集资金利息收入扣除银行手续费后净额	7,008.74
三、报告期期末募集资金余额	31,708.16

注：以前年度已使用金额136,243.43万元与《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中募投项目累计使用金额151,352.40万元存在差异，系由于募集资金投资项目“吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目”变更为“智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期”，原项目已投入募集资金已全部归还至募集资金专项账户。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金172,794.47万元，累计利息收入扣除手续费净额7,008.74万元，公司募集资金专户账户余额合计为31,708.16万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，2020年5月8日，公司2020年度第一次临时股东大会审议通过《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》。公司结合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司的实际情况，2023年4月18日，公司2022年年度股东大会审议修订了《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》。公司结合《上市公司募集资金监管规则》、《上市公司章程指引》以及公司的实际情况，2025年11月14日，公司2025年第二次临时股东大会审议修订了《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》。

2021年2月23日与2022年2月14日，公司与东莞证券股份有限公司在东莞市分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行、交通银行股份有限公司东莞分行、中信银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞分行、广发银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

为提高募集资金使用效率，维护全体股东权益，2025年5月12日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将原计划使用于“吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目”(以下简称“吉安生益电子”)变更为生益电子，已投入到原项目中的募集资金将在股东大会审议通过后以自有资金全部归还至募集资金专项账户。截止2025年6月20日，公司将原项目已投入募集资金已全部归还至募集资金专项账户。因涉及募集资金投资项目变更和项目实施主体变更，2025年6月20日，公司、保荐机构东莞证券股份有限公司与广发银行股份有限公司东莞分行签订了《<募集资金专户存储三方监管协议>之补充协议》，公司、公司全资子公司吉安生益、保荐机构东莞证券股份有限公司及广发银行股份有限公司东莞分行签署了《<募集资金专户存储三方监管协议>之解除协议》。变更后的三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2026年3月4日，鉴于公司新增保荐机构，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司、保荐机构中信证券股份有限公司及东莞证券股份有限公司与募集资金监管银行广发银行股份有限公司东莞分行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行职责。截至2025年12月31日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间			2021年2月19日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
生益电子	中国建设银行股份有限公司东莞万江支行	44050177610809987777	0.00	已注销
生益电子